
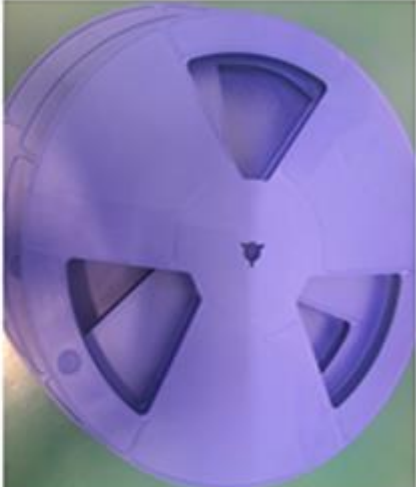




Title of Change:	Product Bulletin of Conversion from Paper Reel to Plastic Reel on all Devices in SMA, SMB, SMC, SDIP, MDIP and SOIC-4 Packages	
Effective date:	19 September 2018	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <benjo.rulona@onsemi.com>	
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input checked="" type="checkbox"/> Other Reel material from paper to plastic	
Change Sub-Category(s):	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input checked="" type="checkbox"/> Other: <u>Reel material from paper to plastic</u>	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: Taiwan Subcon China Subcon
Description and Purpose: Change From: Paper Reel Change To: Plastic Reel Affected Devices are in SMA, SMB, SMC, SDIP, MDIP and SOIC-4 packages. Purpose is for Process robustness and quality improvement as paper is subject to degradation. This is also to standardize the material of the reels for all packages.		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>paper reel</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>plastic reel</p>  </div> </div>		

**List of Affected Parts:**

DF005S	ES1H	RGF1D	S3B
DF005S1	ES1J	RGF1G	S3D
DF005S2	ES2A	RGF1J	S3G
DF01S	ES2B	RGF1K	S3J
DF01S1	ES2C	RGF1M	S3K
DF01S2	ES2D	RS1A	S3M
DF02S	ES3A	RS1B	S3N
DF02S1	ES3B	RS1D	SS12
DF02S2	ES3C	RS1G	SS13
DF04S	ES3D	RS1J	SS14
DF04S1	ES3J	RS1K	SS15
DF04S2	GF1A	RS1M	SS16
DF06S	GF1B	S100	SS18
DF06S1	GF1D	S1A	SS19
DF06S2	GF1G	S1B	SS22
DF08S	GF1J	S1D	SS23
DF08S1	GF1K	S1G	SS24
DF08S2	GF1M	S1J	SS25
DF10S	MB10S	S1K	SS26
DF10S1	MB1S	S1M	SS28
DF10S2	MB2S	S210	SS29
EGF1A	MB4S	S2A	SS32
EGF1B	MB6S	S2B	SS33
EGF1C	MB8S	S2D	SS34
EGF1D	MBRS130	S2G	SS35
ES1A	MBRS130L	S2J	SS36
ES1B	MBRS140	S2K	SS38
ES1C	MBRS320	S2M	SS39
ES1D	MBRS340	S310	SSA210
ES1F	RGF1A	S320	SSA24
ES1G	RGF1B	S3A	SSA36

NOTE:

Please be informed that there are Customer Specific parts impacted by this notice, thus MPN & CPN info will not be reflected in the parts list of this Generic document. Instead please click the link to the addendum copy provided in the email notification to see full list of affected products specific to your company.

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



製品速報

文書番号: PB22420X

発行日: 19 September 2018

変更の件名:	SMA、SMB、SMC、SDIP、MDIP および SOIC-4 パッケージ品における紙リールからプラスチックリールへの変更に関する製品速報	
発効日:	19 September 2018	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <benjo.rulona@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知の種類:	本製品速報は通知目的のみです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。	
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他 紙からプラスチックへのリール材料	
変更サブカテゴリ:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 </div> <div> <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 </div> <div> <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input checked="" type="checkbox"/> その他: 紙からプラスチックへのリール材料 </div> </div>	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部ファウンドリまたは下請け業者拠点: 台湾サブコン 中国サブコン
<p>説明および目的:</p> <p>変更前: 紙リール 変更後: プラスチックリール</p> <p>対象デバイスは SMA、SMB、SMC、SDIP、MDIP および SOIC-4 パッケージ品です。 紙は劣化する可能性があることから、プロセスの堅牢性および品質向上を目的に変更を行います。また、これはすべてのパッケージでリール材料を標準化するためでもあります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>paper reel</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>plastic reel</p>  </div> </div>		



影響を受ける部品の一覧:

DF005S	ES1H	RGF1D	S3B
DF005S1	ES1J	RGF1G	S3D
DF005S2	ES2A	RGF1J	S3G
DF01S	ES2B	RGF1K	S3J
DF01S1	ES2C	RGF1M	S3K
DF01S2	ES2D	RS1A	S3M
DF02S	ES3A	RS1B	S3N
DF02S1	ES3B	RS1D	SS12
DF02S2	ES3C	RS1G	SS13
DF04S	ES3D	RS1J	SS14
DF04S1	ES3J	RS1K	SS15
DF04S2	GF1A	RS1M	SS16
DF06S	GF1B	S100	SS18
DF06S1	GF1D	S1A	SS19
DF06S2	GF1G	S1B	SS22
DF08S	GF1J	S1D	SS23
DF08S1	GF1K	S1G	SS24
DF08S2	GF1M	S1J	SS25
DF10S	MB10S	S1K	SS26
DF10S1	MB1S	S1M	SS28
DF10S2	MB2S	S210	SS29
EGF1A	MB4S	S2A	SS32
EGF1B	MB6S	S2B	SS33
EGF1C	MB8S	S2D	SS34
EGF1D	MBRS130	S2G	SS35
ES1A	MBRS130L	S2J	SS36
ES1B	MBRS140	S2K	SS38
ES1C	MBRS320	S2M	SS39
ES1D	MBRS340	S310	SSA210
ES1F	RGF1A	S320	SSA24
ES1G	RGF1B	S3A	SSA36

注:

本通知により影響を受ける顧客特定部品があり、よってMPN およびCPN 情報は本一般文書の部品リストに反映していないことにご留意ください。代わりに、特に御社に影響する製品の全リストを見るためには電子メール通知で提供される補遺コピーへのリンクをクリックしてください。